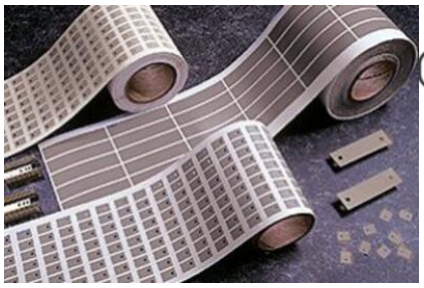
OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

SIL PAD TSP 1800

Sil-Pad®1200

SIL PAD TSP 1800
Exceptional Performance, Silicone based, Fiberglass-reinforced, Thermally Conductive Elastomeric Material



- Lämpöimpedanssi: 0.53°C-in2/W (@50 psi)
- Poikkeuksellinen lämmönsiirto alhaisemmilla paineilla
- Tasainen ja ei-tahmea molemmilta puolilta helppoa uudelleenasennusta, käyttömukavuutta ja kokoonpanovirheiden vähentämistä varten
- Erinomainen rikkoutumisjännite ja pinnan "wet out" -arvot
- Suunniteltu sovelluksiin, joissa sähköinen eristys on tärkeää sekä erinomainen läpikatkaisunkestävyys ruuvi- ja klippikiinnityksillä

TUOTEKUVAUS

BERGQUIST® SIL PAD TSP 1800 on silikonipohjainen lasikuituvahvisteinen lämpöliitäntämateriaali, jossa on sileä ja erittäin joustava pinta.

Materiaali on ei-tahmea, mikä helpottaa sen uudelleenasennusta ja käyttöä, ja siinä on valinnainen liimapinnoite. BERGQUIST SIL PAD TSP 1800 tarjoaa poikkeuksellisen lämmönsiirron suorituskyvyn alhaisemmillakin käyttöpaineilla.

Materiaali soveltuu erinomaisesti elektronisten teholaitteiden ja lämmönpoistimien väliseen asennukseen ruuvi- ja klippikiinnityksillä.